

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-031

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2016年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日

2、预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的 净利润	比上年同期下降 43.88%-52.51%	盈利：2316.30 万元
	1100 万元——1300 万元	

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司2016年上半年业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要为报告期内营业收入下降所致，营业收入因市场不景气预计同比下降10%—15%，其中，公司自制的SMD、DIP等产品的销售收入预计同比下降20%。

2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为185万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年7月14日